Produktdatenblatt

Integrierte Lot-Preforms

Einführung

InTEGRATED® Solder Preforms (Integrierte Lot-Preforms) sind durch feine, präzise Lotstränge in einer Matrix verbunden. Während des Lötvorgangs schmilzt das Lot und fließt zu benachbarten Pads, was zu einer vollständigen Trennung der Preforms führt.

Anwendungen

Integrierte Lot-Preforms ersparen Montagezeit und Personalkosten, da alle Lot-Preforms, die für Anschluss-Pins, Pin Grid Arrays (PGAs) und anderen Viel-Pad/Pin Bauteilen erforderlich sind, gleichzeitig platziert werden. Lot-Preforms erleichtern sowohl die Baugruppenmontage als auch das Produktdesign selbst, da der Anwender die Anfertigung komplexester Arrays spezifizieren kann - einschließlich solcher, die mit konventionellen Methoden unmöglich oder viel zu teuer zu produzieren wären. Es können sogar Arrays mit integrierten Rahmen entworfen werden, um die Handhabung im manuellen Montageprozess zu erleichtern.

Integrierte Lot-Preforms können auch in Non-Array Konfigurationen für Anwendungen wie Vakuum/Kryogenik-Abdichtungen und andere mechanische Montagevorgängen verwendet werden.

Verfügbare Metalle und Legierungen

Integrierte Lot-Preforms können aus reinem Indium, Blei und Silber oder jeder Kombination aus diesen Materialien hergestellt werden. Auf Anfrage evaluieren wir weitere Metalle und Legierungen auf ihre Anwendbarkeit für die integrierte Lot-Preform Technologie.

Array-Pitch Toleranz-Nicht kumulativ

Genauigkeit Mittelpunkt zu Mittelpunkt +/- 5µm (0,0002”)

Formate

Da die Spezifikationsgrenzen je nach Legierung, Stärke und Form des Preforms und anderen Faktoren unterschiedlich sind, wenden Sie sich für Empfehlungen zu Ihrer speziellen Anwendung bitte an Indiums Vertriebs- oder Technikmitarbeiter.

Reflow-Methoden

Integrierte Lot-Preforms können mit den meisten Reflow-Methoden verarbeitet werden, einschließlich: I/R, Laser, Dampfphase, Wärmeleitung oder Heißluftpistolen.

Verpackung

Standardverpackung sind steife Pappdeckel in Argon-gefüllten Poly-Beuteln. Spezialverpackungen sind auf Anfrage erhältlich.

Haltbarkeit

Die Haltbarkeit von Lot-Preforms hängt von der jeweiligen Zusammensetzung der Legierung ab. Bleifreie Legierungen und solche, die weniger als 70% Blei enthalten, weisen eine Haltbarkeit von einem Jahr ab dem Herstellungsdatum auf. Die Haltbarkeit von Legierungen mit einem höheren Bleianteile liegt bei 6 Monaten ab Herstellungsdatum.

Technischer Kundendienst

Die international erfahrenen Ingenieure der Indium Corporation bieten unseren Kunden eingehende technische Unterstützung. Mit gründlichen Kenntnissen in allen Bereichen der Materialwissenschaft hinsichtlich des Elektronik- und Halbleitersektors bieten die Ingenieure des Technischen Kundendienstes Expertenratschläge zu Lotmitteleigenschaften, Kompatibilität von Lotlegierungen, sowie Auswahl von Lotmittel-Preform, Drähten, Bändern und Pasten. Die Ingenieure des Technischen Kundendienstes der Indium Corporation beantworten alle technischen Anfragen normalerweise innerhalb von 24 Stunden.

Sicherheitsdatenblätter

Die Sicherheitsdatenblätter für dieses Produkt sind im Internet unter folgender Adresse verfügbar: http://www.indium.com/techlibrary/msds.php

Weitere Produkte: Lot-Preforms, Lotdraht, Lotbänder und –folien, Lötpaste, Lotkugeln, Flussmittel, Lotbarren und andere Lotprodukte.

Dieses Produktdatenblatt dient nur zur allgemeinen Information. Es ist nicht dazu vorgesehen und kann nicht dazu verwendet werden, das Betriebsverhalten der beschriebenen Produkte zu gewährleisten oder zu garantieren, die ausschließlich den der Packung oder Rechnung beiliegenden schriftlichen Garantien unterliegen.

Form No. 98341(G A4) R0

www.indium.com europe@indium.com

ASIEN: Singapore: +65 6268 8678
CHINA: Suzhou, Shenzhen, Liuzhou: +86 (0)512 628 34900
EUROPA: Milton Keynes, Torino: +44 (0) 1908 580400
USA: Utica, Clinton, Chicago: +1 315 853 4900

INDIUM CORPORATION®

ISO 9001 REGISTRIERT